

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2025-048



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请

获上交所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司以全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）为出资主体与专业机构合资成立的私募股权投资基金——苏州璞达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州璞达”）投资的上海超硅半导体股份有限公司（以下简称“上海超硅”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于 2025 年 6 月 13 日获上海证券交易所受理。

上海超硅主要从事全球半导体市场需求最大的 300mm 和 200mm 半导体硅片的研发、生产、销售，同时还从事包括硅片再生以及硅棒后道加工等受托加工业务，已经发展为国际知名的半导体硅片厂商。公司拥有设计产能 70 万片/月的 300mm 半导体硅片生产线以及设计产能 40 万片/月的 200mm 半导体硅片生产线。公司产品已量产应用于先进制程芯片，包括 NAND Flash/DRAM（含 HBM）/Nor Flash 等存储芯片、逻辑芯片等。上海超硅本次拟公开发行人民币普通股 A 股不超过 207,600,636 股，占上海超硅发行后总股本的比例不低于 15%，扣除发行费用后拟募集资金 49.65 亿元。

宁波上融作为有限合伙人出资 32,600 万元持有苏州璞达 99.69% 的投资份额，苏州璞达通过持股 55.25% 的苏州芯广创业投资合伙企业（有限合伙）于 2022 年 11 月向上海超硅投资 10,000 万元（具体内容请详见 2022 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告》（公告编号：2022-095）。截至本公告日，苏州芯广创业投资合伙

企业(有限合伙)持有上海超硅 1,089.5884 万股(本次发行前),持股比例为 0.93%。

上海超硅本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定,能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 16 日